

岡本工作機械製作所 (6125) Q2 決算メモ アウトパフォーム (継続)

18/3 期上期受注 87.7%増の 213 億円、半導体製造装置受注は 5.9 倍の 80 億円の飛躍

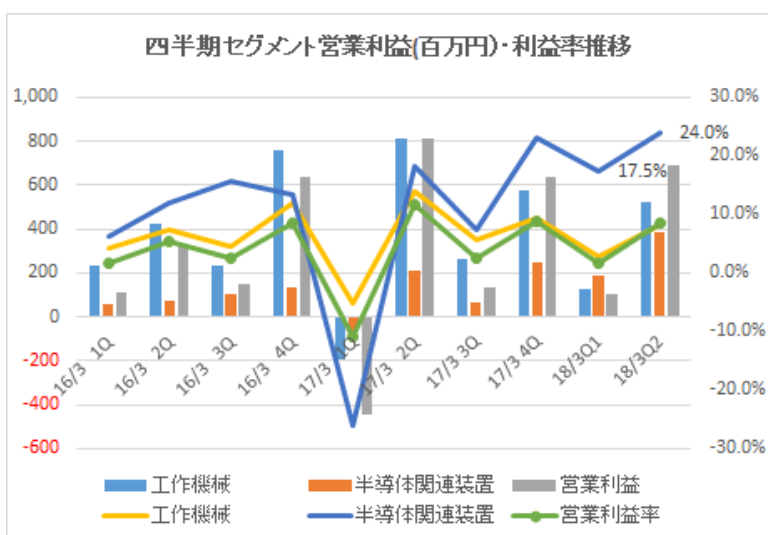
株価 2908 円 (11/13) 時価総額 137 億円 (11/13) 発行済株 47,18 千株 (11/13)
 PER (18/3DO : 9.9X) PBR (1.37X) 配当 (18/3) 50 円 配当利回り : 1.74%

要約

- ・ 18/3 期上期は半導体向け活況で 26%増収、営業利益 2.2 倍増、経常 5.1 倍、受注 87.7%増
- ・ 18/3 期は 17.9%増収、40.4%営業増、75.7%経常増益を変更せず、今後大幅増額必至
- ・ 19/3 期中計目標の売上高 320 億円、営業利益 25.5 億円前倒し達成へ
- ・ 株価は 18/3 期 DO 予想 EPS293 円に対し精密平均 PER26.3 倍の 7700 円目標

18/3 期上期は半導体向け活況で 26%増収、営業利益 2.2 倍増、経常 5.1 倍、受注 87.7%増

11/7 に 18/3 期上期決算の増額推定が開示され 11/13 に 18/3 期上期決算が発表された。18/3 期上期は売上高 137.42 億円 (26.0 増)、営業利益 7.97 億円 (2.2 倍)、経常利益 6.95 億円 (5.1 倍)、税引利益 5.14 億円 (8.2 倍)、受注高 212.55 億円 (87.7%増)、受注残 141.66 億円 (2.6 倍) となった。期初計画比大幅増額で、DO 予想に対して売上高で 2 億円未達成予想も、営業利益で 2.4 億円上回った。



特質すべきは半導体関連装置等の受注が前年同期比 5.9 倍の 79.74 億円 (額にして 66.3 億円増) と活況を呈し、売上高は 26.73 億円 (94.5%増)、営業利益が 5.73 億円 (3.9 倍)、営業利益率が 21.4% (前年同期比 1.08 ポイント改善、Q1 が 17.5%、Q2 は 24.0%) に達した点。しかも受注残高が 71.43 億円 (12 倍、66 億円増) もある。

18/3 期は 17.9%増収、40.4%営業増、75.7%経常増益も半導体関連装置活況で上振れへ

18/3 期会社予想の変更はなく、売上高 280 億円 (17.9%増)、営業利益 16 億円 (40.4%増)、経常利益 13.5 億円 (75.7%増)、税引利益 11 億円 (90.5%増)、配当 50 円予想を据え置いた。逆算で下期は売上高 142.58 億円 (前年同期比 11.0%増)、営業利益 8.03 億円 (同

3.9%増)。会社側は期初説明会で受注高を 300 億円としていたが、すでに上期 212 億円、達成率が 70%を超える。しかも受注残が半導体製造装置で 1 年、工作機械も 6 か月を超えている。下期も工作機械、半導体製造装置とも受注に衰えを見せる要素がなく、受注増と受注残消化が進む中で、会社予想を上回る収益が期待される。

現状、どの工作機械メーカー、半導体製造装置メーカーもボールねじや直線運動用軸受の手当てが間に合わない状況にある。同社は特に半導体製造装置部門は生産能力上限が年間 65 億円程度とのアナウンスもあり、今期はかなりの受注残を積み増す形になるとみられる。工作機械も重要部材のタイト感があるものの、Q4 には多少上積みも期待され、従来 DO 予想の売上高 285 億円をクリアできると判断した。利益面では半導体製造装置だけでなく、工作機械の利益率も向上しており、会社予想を上回る収益が期待される。

なお、アナリスト向け説明会は 12/19(火)15:00 を予定しており、工作機械の部門別内容など詳しくは説明会後に改めてレポートする。

19/3 期中計目標の売上高 320 億円、営業利益 25.5 億円から上乘せも

現在、半導体においては微細化、3D 化投資、さらにはサムコや信越化学の 300mm ウエハ増産設備投資を控え、高付加価値のウエハーポリシャー、ポリシングマシン、グラインディングマシンの活況が続こう。また工作機械関連も、ロボット用歯車新工場がフル稼働し、大きく伸長しよう。特に研削盤は超精密大型研削盤が大型 LCDTV 工場の新設ラッシュ、米国向けに航空機向け需要も拡大しつつある。また LCDTV 設備投資に関連し、同社しか対応できない次世代 LCD フォトマスク用ポリシングマシンなどの受注も期待される。

上記の環境から、19/3 期収益は 19/3 期中計目標の売上高 320 億円、営業利益 25.5 億円を大きく凌駕してこよう。



株価は 18/3 期 DO 予想 EPS293 円に対し精密平均 PER26.3 倍の 7700 円目標に引き上げ

株価は 18/3 期会社予想 EPS249 円に対して 11.7 倍水準と依然割安感がある。下期増額修正見通しで、18/3 期 DO 予想 EPS293 円に対し、半導体製装置受注が飛躍的に伸び営業利益率も前工程製造装置企業並みに高まっており、DO 予想 EPS293 円に対して精密平均

PER26.3 倍の 7700 円を目標株価とする。なお次世代デバイス向け製造装置が量産具体化すれば、エッチングやCMP工程を大幅削減しTSVウエハ全自動薄化が可能となるだけに、次世代半導体製造装置関連銘柄として 19/3 期 DO 予想 EPS497 円に対して PER30 倍の 15000 円まで大変貌する可能性もある。

岡本工作機械(6125)	(百万円、円)									
	売上高	増減率	営業利益	増減率	経常利益	増減率	税引利益	増減率	EPS	配当
16/3期	25,625	-2.0%	1,226	-14.3%	971	-6.2%	967	-7.0%	127.0	30.00
17/3Q1	4,027	-34.5%	-444	-503.6%	-541	-478.3%	-541	-478.3%	-129.6	0.00
17/3Q2	6,882	9.8%	810	144.0%	676	180.5%	709	194.2%	144.0	0.00
17/3Q3	5,607	-5.1%	135	-10.0%	77	79.1%	126	193.0%	21.6	0.00
17/3Q4	7,233	-1.0%	638	0.6%	556	2.2%	556	3.0%	94.4	40.00
17/3H1	10,909	-12.1%	366	-17.2%	135	-64.8%	168	-56.3%	14.4	0.00
17/3H2	12,840	-2.8%	773	-1.4%	633	7.8%	682	17.0%	116.0	40.00
17/3期	23,749	-7.3%	1,139	-7.1%	768	-20.9%	850	-12.1%	130.4	40.00
18/3Q1	5,675	40.9%	103	黒転	68	黒転	37	黒転	8.5	0.00
18/3Q2(8/9)会予	7,325	6.4%	397	-51.0%	282	-58.3%	213	-70.0%	48.0	20.00
18/3Q2	8,067	17.2%	694	-14.3%	627	-7.2%	477	-32.7%	107.7	20.00
18/3H1期初会予	13,000	19.2%	500	36.5%	350	158.8%	250	292.7%	56.5	20.00
18/3H1	13,742	26.0%	797	117.8%	695	414.8%	514	206.0%	116.2	20.00
18/3H2期初会予	15,000	16.8%	900	16.4%	1,000	58.0%	850	24.6%	192.1	20.00
18/3H2会予(11/13)	14,258	11.0%	803	3.9%	655	3.5%	586	-14.1%	132.4	30.00
18/3期初会予	28,000	17.9%	1,600	40.5%	1,350	75.8%	1,100	29.4%	248.6	50.00
18/3H1DO予(8/10)	13,200	21.0%	550	50.3%	400	196.3%	300	376.2%	68.0	20.00
18/3H2DO予(8/10)	15,300	19.6%	1,250	63.6%	1,150	84.0%	950	87.4%	214.7	30.00
18/3H2DO予(11/13)	14,758	14.9%	1,203	55.6%	955	50.9%	786	15.2%	223.7	30.00
18/3期DO予(8/10)	28,500	20.0%	1,800	58.0%	1,550	101.8%	1,250	116.6%	282.5	50.00
18/3期DO予(11/13)	28,500	20.0%	2,000	75.6%	1,650	114.8%	1,300	52.9%	293.8	50.00
19/3期DO予(8/10)	34,500	21.1%	3,000	66.7%	2,850	83.9%	2,000	60.0%	451.2	70.00
19/3期DO予(11/13)	36,000	26.3%	3,200	60.0%	2,900	75.8%	2,200	69.2%	497.2	80.00

半期	17/3H1	17/3H2	18/3H1	18/3H2D O予	19/3H1D O予	19/3H2D O予
売上高	10,909	12,840	13,742	14,758	17,100	18,900
営業利益	366	773	797	1,203	1,500	1,700
経常利益	135	633	695	955	1,300	1,600
親株主帰属純利益	168	682	514	586	970	1,230
半期セグメント売上情報	17/3 2Q	17/3 4Q	18/3Q2	18/3Q4D O予	19/3Q2D O予	19/3Q4D O予
工作機械	9,535	10,912	11,069	11,231	12,500	13,500
半導体関連装置	1,374	1,927	2,673	3,527	4,600	5,400
売上合計	10,909	12,840	13,742	14,758	17,100	18,900
半期セグメント営業利益	17/3 2Q	17/3 4Q	18/3Q2	18/3Q4D O予	19/3Q2D O予	19/3Q4D O予
工作機械	623	842	650	950	1,000	1,100
半導体関連装置	146	311	573	727	1,050	1,200
合計	769	1,153	1,223	1,677	2,050	2,300
調整額	-403	-380	-426	-474	-550	-600
営業利益	366	773	797	1,203	1,500	1,700
半期セグメント受注	17/3 2Q	17/3 4Q	18/3Q2	18/3Q4D O予	19/3Q2D O予	19/3Q4D O予
工作機械	9,978	10,936	13,281	12,719	13,500	14,000
半導体関連装置	1,344	3,109	7,974	5,026	7,500	6,500
受注合計	11,247	14,120	21,255	17,745	21,000	20,500
利益率	17/3H1	17/3H2	18/3H1	18/3H2D O予	19/3H1D O予	19/3H2D O予
売上高	131.8%	155.2%	166.1%	178.4%	206.7%	228.4%
営業利益	4.4%	9.3%	9.6%	14.5%	18.1%	20.5%
経常利益	1.6%	7.7%	8.4%	11.5%	15.7%	19.3%
親株主帰属純利益	2.0%	8.2%	6.2%	7.1%	11.7%	14.9%
半期セグメント営業利益率	17/3H1	17/3H2	18/3H1	18/3H2D O予	19/3H1D O予	19/3H2D O予
工作機械	6.5%	7.7%	5.9%	8.5%	8.0%	8.1%
半導体製造装置	10.6%	16.1%	21.4%	20.6%	22.8%	22.2%
合計	7.0%	9.0%	8.9%	11.4%	12.0%	12.2%
調整額	-3.7%	-3.0%	-3.1%	-3.2%	-3.2%	-3.2%
営業利益	3.4%	6.0%	5.8%	8.2%	8.8%	9.0%

OKAMOTO MACHINE TOOL WORKS,LTD.

2017/11/13

